

Tera Probe

第7期 株主通信

2011年4月1日～2012年3月31日

グループ丸となってビジネスの成長と拡大に取り組みます



代表取締役社長兼CEO
渡辺 雄一郎

株主の皆様には格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2011年度は、タイの洪水の影響や、電力の供給能力不足による節電を求められるなど厳しい事業運営を強いられる一年となりました。このような環境の下、10月から新たに株式会社テラミクロスが当社グループに加わり、ウエハレベルパッケージ (WLP) という非常に小さく薄い半導体パッケージの製造を手がけることが出来るようになりました。これにより、当社グループは半導体製造工程のウエハ製造以降のすべての工程を受託することが可能となり、特に海外の生産ラインを持たない顧客に対して「ターンキーサービス」という一貫したサービスを提供できる強力な体制を構築することが出来ました。今年度はこの強みを生かし、海外での営業活動を強化していく所存です。

一方では、システムLSI事業の収益改善を目指し営業活動を展開してまいりましたが、今年度も黒字化には至りませんでした。そこで、今後の九州事業所の収益性を保守的に見積もり、固定資産を減損処理することといたしました。

2011年度は当社グループにとってもう一つ大きな出来事がありました。当社の主要顧客であり、筆頭株主でもあるエルピーダメモリ株式会社が会社更生法による再建を目指すこととなりました。これにより、当社グループも売掛金などの回収が滞ることとなり、株主の皆様にもご心配をおかけいたしました。

また、これらの影響で、株主の皆様にお約束していた配当金についてもお出しすることが難しい状況となってしまいました。株主の皆様には深くお詫び申し上げます。

当社のメモリ事業につきましては、エルピーダメモリ株式会社の再建計画が決定するまで明確なお話が出来ませんが、当面は同社広島工場の生産が継続しており、当社のテスト業務も従前通り継続していることを株主の皆様にご報告させていただきます。

本年度も様々な出来事が待ち受けていると思いますが、グループ丸となってビジネスの拡大に努めてまいりますので、株主の皆様には変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

WLPの受託がはじまり売上高が前期比13.1%増

売上高 **241億90**百万円
(前期比13.1%増)

営業利益 **27億10**百万円
(前期比47.7%減)

経常利益 **24億2**百万円
(前期比50.3%減)

当期純損益 **△55億29**百万円

メモリ事業

DRAM市場の悪化に伴う主要顧客の生産調整などの影響から、当連結会計年度の売上高は197億45百万円(前期比0.7%増)となりましたが、減価償却費の増加等により、セグメント利益は49億70百万円(同30.2%減)となりました。

システムLSI事業

既存製品では、洪水の影響による生産調整やデジタル家電の販売不振に伴い顧客の在庫調整などがありましたが、新規顧客の獲得や新規製品の受託のほか、新たに連結子会社となった株式会社テラミクロスの売上也加わり、売上高は大幅に増加いたしました。しかし、利益面では既存製品の受託減少を補うまでには至らず、当連結会計年度の売上高は45億29百万円(前期比154.1%増)、セグメント損益は9億98百万円の損失(前期は8億72百万円の損失)となりました。

また、当連結会計年度は次の事由による特別利益、及び特別損失を計上しております。

特別利益

- 企業立地協定に基づき熊本県からの補助金交付を受ける [2億63百万円]
- 連結子会社株式会社テラミクロスの資産評価確定により、負ののれんを計上 [5億59百万円]

特別損失

- エルピーダメモリ株式会社の会社更生法の申請に伴い、同社向け債権について貸倒引当金を計上 [27億1百万円]
- 九州事業所の固定資産の減損損失を計上 [53億88百万円]

Q&A

今回の株主通信では、投資家の皆さまからいただく半導体業界とテラプローブの事業についてのお問い合わせに、Q&A形式でお答えします。

Q1 テラプローブがテストをしている半導体は、どのようなものに使われているのですか？

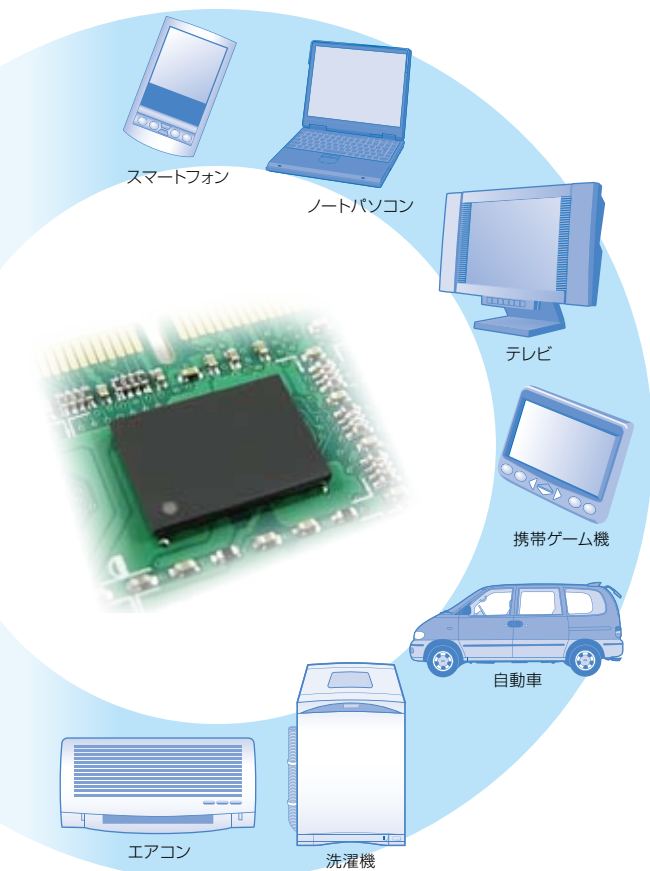
A1 身の回りにある様々な製品に半導体は使われています。

今、私たちの生活のあらゆる場面に半導体関わっています。

スマートフォンや携帯電話をはじめ、テレビ、エアコン、洗濯機など家電製品や、自動車、電車などの交通手段のほか、電気、ガス、水道などのインフラにも半導体は不可欠な存在となっています。

特に、成長著しいモバイル機器や、環境問題から注目が集まっている省エネのためのパワーコントローラーなど、今後も需要の伸びが期待される分野には、必ず半導体が重要な役割を果たしています。

当社グループでは、スマートフォンなどのモバイル機器用半導体製品のテストやWLPを多数手がけております。



Q2 テラプローブの業績は、半導体メーカーの業績に連動するのですか？

A2 コストを基にテスト価格が決まるため、製品の市場価格とは連動しません。

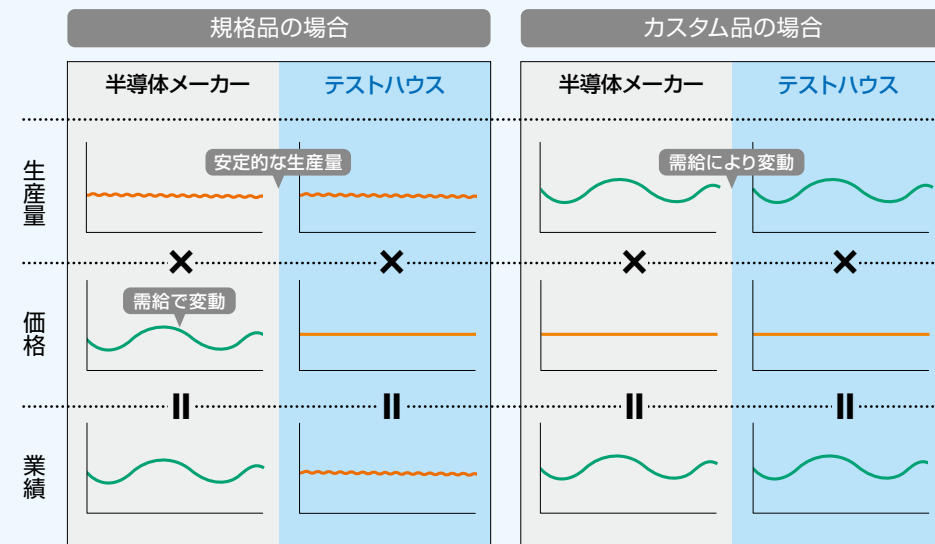
テラプローブの顧客である半導体メーカーの業績は、最終製品の需給によって、大きく変動します。

半導体にはいくつか種類があり、「決められた規格に従って生産される」規格品と、「最終製品の個々の仕様に合わせて作られる」カスタム品では、生産と販売方法が大きく異なります。規格品は決められた規格に従って効率よく生産さ

れ、販売価格は需給のバランスによって決まります。カスタム品は、使用される最終製品の生産計画に沿って生産されるため、その製品の売れ行きに合わせて半導体の生産数量が大きく変動します。

このように、規格品とカスタム品、どちらの場合も半導体メーカーの収益は、最終製品の販売量によって影響を受けませんが、テラプローブのように特定の工程を受け持つ企業にとっては、カスタム品は最終製品の販売量に影響を受けるものの、規格品はカスタム品より安定的に生産され、また保有設備を有効に使えることから、より安定した収益が期待できます。

半導体メーカーとテストハウス*の収益構造の違い



半導体メーカーとテストハウス、それぞれの売上は「生産量」と「価格」の掛け算で求められます。半導体メーカーの売上は規格品、カスタム品ともに生産量あるいは価格の影響を受けて変動します。テラプローブのようなテストハウスの売上は、テスト価格が生産量の影響を受けにくいいため、特に規格品において安定しています。

*テストハウス・・・半導体製造プロセスのテスト工程を受託する専門会社。

連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2011年3月末	2012年3月末
<資産の部>		
流動資産	14,698	10,675
現金及び預金	7,211	5,557
受取手形及び売掛金	3,774	3,537
その他	3,712	1,580
固定資産	35,626	30,412
有形固定資産	34,256	28,801
その他の固定資産	1,369	1,610
資産合計	50,325	41,088
<負債の部>		
流動負債	15,516	11,298
固定負債	8,251	8,591
負債合計	23,767	19,890
<純資産の部>		
株主資本	25,175	19,645
資本金	11,823	11,823
資本剰余金	11,380	11,380
利益剰余金	1,972	△3,557
その他の包括利益累計額	△281	△298
少数株主持分	1,663	1,851
純資産合計	26,557	21,198
負債純資産合計	50,325	41,088

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2010年度 (2010年4月1日~ 2011年3月31日)	2011年度 (2011年4月1日~ 2012年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,382	9,813
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,503	△10,671
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,532	△804
現金及び現金同等物に係る換算差額	△21	9
現金及び現金同等物の増減額(△減少)	4,390	△1,653
現金及び現金同等物の期首残高	2,820	7,211
現金及び現金同等物の期末残高	7,211	5,557

連結損益計算書

(単位:百万円)

	2010年度 (2010年4月1日~ 2011年3月31日)	2011年度 (2011年4月1日~ 2012年3月31日)
売上高	21,381	24,190
売上原価	14,532	19,395
売上総利益	6,849	4,794
販売費及び一般管理費	1,667	2,084
営業利益	5,181	2,710
営業外収益	68	167
営業外費用	414	475
経常利益	4,835	2,402
特別利益	246	1,069
特別損失	201	8,195
税金等調整前当期純損益	4,880	△4,723
法人税等	339	602
少数株主利益	389	203
当期純損益	4,151	△5,529

連結株主資本等変動計算書

(単位:百万円)

	2011年 3月末	2011年度中 の変動額	2012年 3月末
資本金	11,823	—	11,823
資本剰余金	11,380	—	11,380
利益剰余金	1,972	△5,529	△3,557
株主資本合計	25,175	△5,529	19,645
その他の包括利益累計額合計	△281	△16	△298
少数株主持分	1,663	187	1,851
純資産合計	26,557	△5,359	21,198

会社概要 (2012年3月31日現在)

社 名 株式会社テラプローブ (英文名称:Tera Probe, Inc.)
 設 立 2005年8月
 資 本 金 118億2331万円
 従 業 員 数 連結660名 (単体294名)
 事 業 内 容 メモリ事業
 (DRAM等メモリ製品のウエハテスト及び開発受託)
 システムLSI事業
 (SoC、イメージセンサ、アナログ等各種半導体製品の
 ウエハテスト、ファイナルテスト、開発受託、及びウ
 エハレベルパッケージ)

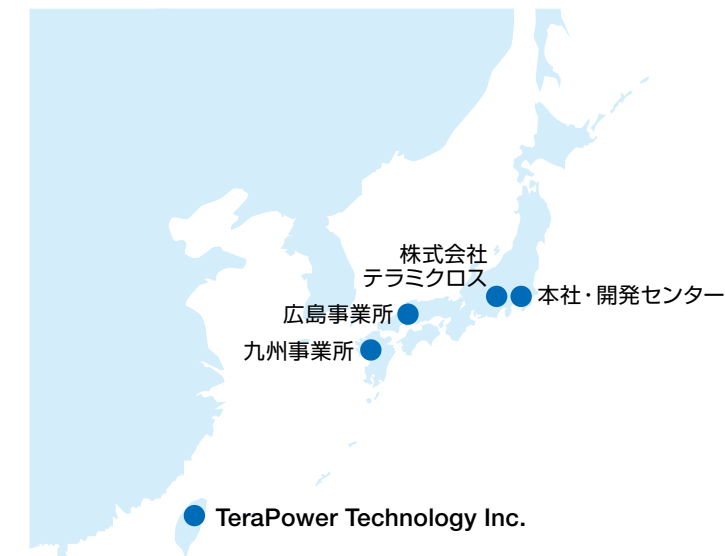
事業拠点 (2012年3月31日現在)

本社・開発センター
 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-17
 広島事業所
 広島県東広島市吉川工業団地7-10
 九州事業所
 熊本県葦北郡芦北町湯浦1580-1

株式会社テラミクロス
 東京都青梅市今井3-10-6
TeraPower Technology Inc.
 No.26, Wenhua Rd., Hsinchu Industrial Park, Hukou,
 Hsinchu 303, Taiwan

役員 (2012年6月25日現在)

代表取締役社長 渡辺 雄一郎 常勤監査役 太田 利昌
 代表取締役副社長 小平 広人 監査役 縣 啓二
 取締役 横山 毅 監査役 森 直樹
 社外取締役 高木 裕



株主メモ

上場証券取引所 東京証券取引所マザーズ
証券コード 6627
事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
株式の売買単位 100株
公告方法 公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむをえない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
公告掲載URL <http://www.teraprobe.com/>
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
同連絡先 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
☎0120-176-417
<http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html>

テラプローブでは本社・開発センター、広島事業所および九州事業所において以下の認証を取得しております。

品質
マネジメントシステム



FS 503595
ISO9001:2008

環境
マネジメントシステム



EMS 523947
ISO14001:2004

情報セキュリティ
マネジメントシステム



IS 523042
ISO27001:2005

労働安全衛生
マネジメントシステム



OHS 581214
OHSAS18001:2007

ホームページのご案内



当社では、株主・投資家の皆様にプレスリリースや決算説明資料などのIR情報をホームページにて公開しております。是非、ご覧ください。

<http://www.teraprobe.com/>

過去の開示資料は、ホームページ内「IR資料室」に掲載しております。
<http://ir.teraprobe.com/ja/IRLibrary.html>

株式会社テラプローブ

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-17